

IEEE Electronics Packaging Societyのご紹介

November 27, 2020
IEEE-EPS Japan Chapter Chair 青木 重憲

IEEEとは (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- 活動分野：電気工学を源流とする通信・電子・情報工学とその周辺
- 標準化活動：電気関係の工業規格を広範に策定（WiFiなど）
- **会員規模：世界160か国に42万人**
- **分科会：専門ごとの計39のSocietyで独自に活動**



EPS: Electronics Packaging Society とは

IEEEの39の専門分科会のうちのひとつ（3年前にCPMTから改称）

- 活動分野：各種の部品・材料、先端的プロセス技術・実装技術、生産技術
- **規模：全世界で2300人、日本は200人**
- 主催国際会議：**ECTC(米)**、EPTC(亜)、ESTC(欧)、**ICSJ(日)**、など
- **ロードマップ活動：Heterogenous Integration Roadmap(HIR)**
 - 2016年にITRS 半導体技術RMが終了した後の **実装業界の道しるべ**
 - 毎年のアップデートで最新技術を網羅
 - ドキュメントは全23章の力作。IEEE-EPS (US) のHPから**無料でダウンロード可能**

IEEE-EPSS会員になるには

■ オンラインで24h登録可

- 年会費：初年度\$173 (= IEEE \$158 + EPS \$15)、入会金不要
- 手続きなど詳細は、<https://iee-jp.org/kaiin/guide.html> 参照

■ 基本特典

- **Conference割引：主催国際会議がそれぞれ\$100~150割引**
- 主催雑誌"IEEE Trans. on CPMT"の無料オンライン購読
- 関係雑誌の購入割引

EPS Japan会員だけの追加特典

■ イブニングミーティングへの無料招待

～第一線の研究者による、実装周辺領域も含む先端R&D技術のレビュー

- **年4回**：2021年は 3/05、7/02、9/24、11/26 を予定
- 会場：東京エリア + **ウェブ配信**
- **参加費：EPS会員 ¥0**（通常は他のIEEE会員 ¥2,000 / 一般 ¥5,000）
- これまでの主なトピックス
 - '19-20年：パワーデバイス実装、HPC実装、冷却、先端スマホのパッケージ、微細接合
 - 内容詳細や2018年以前の案件は、IEEE-EPS JapanのHPに掲載

■ 主なJIEP主催会議・研究会参加費の協賛割引

- **ICEP、講演大会、MES、など（2,000～5,000円の割引）**

その他、数字に表れない加入メリット

■ 一般会員なら、

- 組織の枠を超えた交流 ⇒ **オープンイノベーション推進、転職の足掛かり**

■ さらに 委員（現25名）になると、

- 業界キーパーソンとの交流 ⇒ **ビジネスチャンス拡大、海外展開への入り口**
- HIR活動など学会イベント企画への参画 ⇒ **世界の実装業界の方向性に関与**
- 委員の肩書 ⇒ **学会や研究会に参加しやすく**

・ぜひIEEE-EPSにご加入/更新ください。

・委員に関心ある方は Chair宛メールください("IEEE-EPS Japan > 委員"にアドレス掲載)

- 論文投稿など実績不問：熱意あるEPS会員からの連絡をお待ちします

- 関東エリア外の方も歓迎：ネット活用で全国からのストレスフリーな参加を推進中